



## BOLIX Z

### klej do przyklejania styropianu

#### ■ ZASTOSOWANIE:

Służy do przyklejania płyt styropianowych do typowych podłoży mineralnych. Stosowany jest przy docieplaniu ścian zewnętrznych budynków w technologii bezspoinowego systemu ociepleń.

*UWAGA! Do wykonania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych należy stosować klej uniwersalny BOLIX U.*

#### ■ TECHNOLOGIA WYKONANIA:

##### ■ Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Gładkie powierzchnie betonowe zmatowić grubym papierem ściernym, odpylić i zagruntować preparatem BOLIX T. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczą murarską BOLIX W. Podłoże chłonne zagruntować preparatem gruntującym BOLIX T. Okres schnięcia zastosowanego na podłożu preparatu BOLIX N lub BOLIX T wynosi min. 4-6 h w optymalnych warunkach pogodowych (przy względnej wilgotności powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C).

##### ■ Przygotowanie produktu:

Zawartość opakowania wylać do pojemnika z odmierzoną ilością wody (4,80 ÷ 5,30 litra) i dokładnie wymieszać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. W zależności od temp. i wilgotności powietrza przygotowana zaprawa jest przydatna do użycia przez ok. 1 h. Przygotowanie, aplikacja i schnięcie zaprawy wymagają temperatury w przedziale od +5°C do +25°C (dotyczy również temp. podłoża). W trakcie prac należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, opadów deszczu oraz silnego wiatru.

##### ■ Zastosowanie produktu:

Przygotowaną zaprawę klejącą nakładać na płytę styropianową metodą „pasmowo-punktową”, czyli pasmami o szer. ok. 3-6 cm, układanymi w odległości ok. 3 cm od krawędzi płaszczyzny płyty, a na pozostałej powierzchni równomiernie rozłożonymi „plackami” w ilości od 8-10 szt. o średnicy 8-10 cm. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Na płytę o wymiarach 100 x 50 cm w środkowej jej części nałożyć 8-10 „placków” zapra-

wy. Po nałożeniu zaprawy, płytę bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć pacą. Styropian przyklejać z zachowaniem mijankowego układu płyt. Po dostatecznym związaniu zaprawy (min. po 48 h), przyklejone płyty należy zawsze mocować łącznikami mechanicznymi zgodnie z projektem technicznym (w ilości nie mniejszej niż 4szt./m<sup>2</sup>). Po czym, przeszlirować całą licową powierzchnię zamocowanych płyt pacą z grubym papierem ściernym.

##### ■ Zalecenia wykonawcze:

- Na nowo wykonanych podłożach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne) można rozpocząć prace przygotowawcze i nakładanie zaprawy klejącej dopiero po jego wyschnięciu, czyli po upływie ok. 3-4 tygodni.
- Przy klejeniu styropianu na chłonnych podłożach mineralnych, należy wcześniej zagruntować te podłoża preparatem BOLIX T.
- Gruntowanie można wykonać jedynie na powierzchni wyschniętej, dopiero po upływie właściwego dla danego podłoża okresu wiązania i twardnienia.
- Należy odpowiednio dopasować możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania (biorąc pod uwagę ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, istniejący stan podłoża i panujące warunki atmosferyczne).
- Proces przygotowania, przyklejenia i wiązania zaprawy klejącej powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze powietrza od +5°C do +25°C.
- Zaprawę klejącą należy nakładać na podłoża o temperaturze od +5°C do +25°C.
- Nowo wykonane warstwy należy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5°C i powyżej +25°C do czasu wiązania.
- Podczas realizacji robót dociepleniowych, zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych.
- Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania kleju.
- Należy pamiętać o właściwym wykonaniu i wykończeniu (profile dylatacyjne) dylatacji występujących w podłożu.



## BOLIX Z

### klej do przyklejania styropianu

- Po zakończeniu nakładania zaprawy klejącej narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, pamiętając że po wyschnięciu kleju czyszczenie jest utrudnione. Powierzchnię świeżo zabrudzonych elementów należy przetrzeć wilgotną szmatką.
- Klej do przyklejania styropianu BOLIX Z jest elementem systemów dociepleń BOLIX i BOLIX S. Pełna i gwarantowana skuteczność tego materiału ma miejsce wówczas, gdy jest on stosowany razem z pozostałymi elementami systemu, zgodnie z technologią wykonania (opisaną w Instrukcji Docieplania BOLIX nr IB/01/2001).
- Do wykonywania warstwy zbrojonej w tych systemach należy zastosować klej uniwersalny BOLIX U.

#### ■ Środki ostrożności:

Wyrób posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem.

#### ■ Wskazówki dodatkowe:

W celu prawidłowego zastosowania produktu przy wykonywaniu docieplenia zalecamy zapoznać się z treścią Instrukcji BOLIX Nr IB/01/2001 - "Docieplanie ścian zewnętrznych budynków".

#### ■ Niezbędne narzędzia:

- Wiadro budowlane
- Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400 ÷ 500 obr/min) z mieszadłem koszykowym
- Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej
- Wiertarka udarowa
- Młotek budowlany
- Paca z gruboziarnistym papierem ściernym

#### ■ DANE TECHNICZNE:

##### ■ Parametry użytkowe zaprawy klejącej:

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- Temperatura podłoża: od +5°C do +25°C
- Proporcje mieszania: 4,8-5,3l wody na 25 kg kleju
- Czas otwarty pracy: ok. 1,0 h
- Splyw: < 0,12 mm
- Przyczepność:
  - przyczepność do betonu: > 0,3 MPa
  - przyczepność do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

#### ■ Dane techniczne i własności produktu:

- Konsystencja: suchy proszek
- Kolor: szary
- Gęstość nasypowa: ok. 1,45 kg/dm<sup>3</sup>

/wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i temperatury powietrza +20°C/

#### ■ ZUŻYCIE:

Zużycie zaprawy klejącej do klejenia płyt styropianowych na odpowiednio przygotowanym podłożu przy wykonywaniu docieplenia budynku wynosi ok. 4,0 kg/m<sup>2</sup>. W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu na danym podłożu zaleca się przeprowadzenie odpowiednich prób.

#### ■ WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU:

Oryginalnie zamknięte opakowania chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania. Okres przydatności do zastosowania: do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

#### ■ DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE:

- Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-2693/2005 oraz AT-15-4193/2005 oraz Nr AT-15-4193/2003
- Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/2188/02/2001
- Certyfikat Nr ITB-0046/Z oraz Nr ITB-003/Z
- Deklaracja zgodności Nr 8/B/2004 z dn. 12.10.2004 oraz 2/1/B/2005 z dn. 30.05.2005.

#### ■ SKŁAD:

Klej BOLIX Z jest suchą mieszanką spoiw hydraulicznych, polimerów, bazy drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących.

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.